JEITA Japan Electronics & Information Technology Industries Association

# JEITA 環境調和型先端実装技術 成果報告会2013

日 時 平成25年7月11日(木) 10:00～17:00 (受付開始 9:30～)
場 所 芝浦工業大学 豊洲キャンパス交流棟(6階) 大講義室
主 催 一般社団法人 電子情報技術産業協会
企 画 JEITA／実装技術標準化専門委員会

## Program

司 会 山本 克己 氏 テクノオフィス・ヤマモト

| | |
|---|---|
| 10:00～10:05 | **主催者挨拶**<br>岡本 正英 JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長 ((株)日立製作所) |
| 10:05～10:10 | **来賓挨拶**<br>浅川 浩二 氏 経済産業省 商務情報政策局 情報通信機器課 デバイス産業戦略室長補佐 |
| 10:10～10:40 | **極小表面実装部品の新しいぬれ性試験方法**<br>平本 清 氏 山陽精工(株) |
| 10:40～11:10 | **「部品内蔵基板の設計データフォーマットの国際標準化」への取り組み**<br>春日 壽夫 氏 IS-INOTEK |
| 11:10～11:40 | **EU-RoHSを中心にした世界の製品含有化学物質規制の動向について**<br>波多野太郎 氏 (株)村田製作所 |
| 11:40～12:10 | **高温鉛入りはんだの鉛フリー化への取り組み(その3)**<br>芹沢 弘二 氏 千住金属工業(株) |

休 憩 (昼食は各自にてお願いいたします)

### METIプロジェクト『フロー槽材料の長期信頼性に係わる各種特性の評価試験方法に関する標準化』活動 最終報告

| | |
|---|---|
| 13:10～13:20 | **METIプロジェクト 3年間の取り組みについて**<br>竹本 正 氏 大阪大学 名誉教授<br>芹沢 弘二 氏 千住金属工業(株) |
| 13:20～13:50 | **窒化処理膜などの拡散タイプ処理膜の損傷メカニズムと評価試験方法**<br>荘司 郁夫 氏 群馬大学 大学院工学研究科 機械システム工学専攻 教授 |
| 13:50～14:20 | **セラミックコート膜などのコーティングタイプ膜の損傷メカニズムと評価試験方法**<br>西川 宏 氏 大阪大学 接合科学研究所 スマートプロセス研究センター 准教授<br>佐々木喜七 氏 (一財)日本電子部品信頼性センター 環境試験所 所長 |
| 14:20～14:45 | **フロー槽材料の耐エロージョン性評価試験方法のIEC及びJIS規格化状況**<br>荒金 秀幸 氏 ソニー(株) |

休 憩

### JEITAプロジェクト『第2世代リフロー用鉛フリーソルダペースト標準化』 活動報告

| | |
|---|---|
| 15:00～15:30 | **JEITA第2世代低銀系ソルダペースト標準品の市場動向**<br>大田 健吾 氏 千住金属工業(株) |
| 15:30～16:00 | **JEITA第2世代低銀系ソルダペースト標準品の採用事例**<br>荒金 秀幸 氏 ソニー(株) |
| 16:00～16:30 | **SAC系はんだ接合寿命予測に関する苅谷モデルの実証実験**<br>山本 剛 氏 富士通アドバンストテクノロジ(株) |
| 16:30～17:00 | **Sn-Bi共晶合金の変形機構と疲労寿命**<br>苅谷 義治 氏 芝浦工業大学 工学部 材料工学科 教授 |

プログラムの内容につきましては、変更となる場合もありますので予めご承知おき下さい。

JEITA

# 環境調和型先端実装技術　成果報告会2013

## ご 挨 拶

当協会では、「実装技術標準化専門委員会」を中心に1997年から実装技術の鉛フリー化活動に取り組んで参りました。またこれらの活動成果は、毎年『報告会』を開催し、広く普及を図って参りました。今年も『JEITA 環境調和型先端実装技術 成果報告会』として、この一年間の鉛フリー化活動成果および環境に優しい先端的な実装技術の検討結果を、ご報告させていただきます。

今回も昨年に引き続き、主に2つのプロジェクトの活動報告を致します。1つ目はMETIプロジェクト『フロー槽材料の長期信頼性に関わる各種特性の評価試験方法に関する標準化』活動です。これは溶融鉛フリーはんだによるフローはんだ付け槽の侵食の評価試験方法に関する国家プロジェクトです。2つ目はJEITAプロジェクト『第2世代リフロー用鉛フリーソルダーペーストの標準化』活動です。現在主流になっているSn-3Ag-0.5Cu鉛フリーソルダーペーストに代わる、より低コストの低銀系ソルダーペーストのJEITA推奨組成に関して、実証化検証結果も含めてご報告致します。何れのプロジェクトも今回が最終報告となりますので、3年間の活動の集大成をご報告させていただきます。

他にも、部品内蔵基板の設計データフォーマット、高温鉛入りはんだの鉛フリー化等、「実装技術標準化専門委員会」が独自に取り組んでいる活動の成果についてご報告致します。関係各位におかれましてはご多用とは思いますが、是非ご参加いただき、忌憚のないご意見、活発なご討論を賜りますようお願い申し上げます。

**JEITA　実装技術標準化専門委員会　委員長　岡本 正英（(株)日立製作所）**

## 参加要領

■日　　時　平成２５年７月１１日（木）１０：００～１７：００（受付開始9:30～）

■場　　所　芝浦工業大学　豊洲キャンパス交流棟（６階）　大講義室
東京都江東区豊洲3-7-5
http://www.shibaura-it.ac.jp/about/campus_toyosu.html

■申 込 方 法　参加申込書に必要事項をご記入の上、お申込み下さい。登録完了時には、登録E-Mailアドレスに確認メールをお送り致します。
また、ご登録のご住所宛に「受講票」と「請求書」をお送り致します。
**申込書は以下リンクよりダウンロードください。**
http://home.jeita.or.jp/tss/2013kankyochowa_EntrySheet.xls
（本状下部の申込書に記入いただき、FAX送信いただいても結構です。）

■申 込 期 限　平成２５年７月５日（金）必着

■定　　員　２００名（定員になり次第締め切らせて頂きますので、お早めにお申し込み下さい。）

■参　加　費　１０，０００円(会員会社)　　１５，０００円（非会員会社）
※　JEITA会員になることをご検討中の非会員会社につきましては、今回は会員扱いとさせて頂きます。後日担当部門から入会手続きのご連絡をさせて頂きます。

■配 布 資 料　成果報告書（当日配布）

■お問合せ先　一般社団法人 電子情報技術産業協会　知的基盤部 標準Ｇ（荻島・澤田）
TEL:03-5218-1059　FAX:03-5218-1078
E-mail:tsc4@jeita.or.jp

## 会場へのアクセス

最寄駅のご案内：東京メトロ有楽町線「豊洲駅」徒歩7分、又はJR京葉線「越中島駅」2番出口より徒歩15分

---

(一社)電子情報技術産業協会／知的基盤部行
FAX:03-5218-1078　E-mail:tsc4@jeita.or.jp

## 「環境調和型先端実装技術　成果報告会2013」参加申込書

| 貴　社　名 | | 会 員 確 認 | 会員 ・ 非会員（いずれかに○を付けて下さい。） |
|---|---|---|---|

※　会員／非会員の確認は、JEITA会員一覧＜http://www.jeita.or.jp/cgi-bin/member/list.cgi＞でお願いします。

| 参加者氏名 | | 所属役職名 | |
|---|---|---|---|
| 連絡先住所 | （〒　　） | | |
| TEL番号 | | FAX番号 | |
| E－mail | | | |

※　複数名の参加申込みの場合は、下記にお書き下さい。(受講票と請求書は参加者毎に別々にお送りします。)

| 参加者氏名 | | 所属役職名 | |
|---|---|---|---|
| 連絡先住所 | （〒　　） | | |
| TEL番号 | | FAX番号 | |
| E－mail | | | |